

Induktivitäten

Kompakte Multilayer-Power-Induktivitäten in Gehäusegröße 1608

- Produktportfolio der TDK Power-Induktivitäten um Miniaturbaureihe erweitert; neue Bauelemente kleiner als Serie 2012
- Neue TDK MLP1608-V-Serie bereits in Massenfertigung

21. Februar 2012

TDK-EPC, ein Unternehmen des TDK-Konzerns, hat sein Produktspektrum von kompakten Multilayer-Power-Induktivitäten um die TDK MLP1608-V-Serie in Größe 1608 erweitert. Die miniaturisierten Bauelemente eignen sich für Stromversorgungsschaltungen mobiler Geräte wie Smartphones, konventionelle Mobiltelefone, Digitalkameras und ähnliche Produkte. Die Massenfertigung der neuen Serie hat bereits begonnen.

Die TDK MLP1608-V-Serie ergänzt die bereits bestehenden Serien in den Baugrößen 2520, 2016 und 2012 (2,5 x 2,0 mm², 2,0 x 1,6 mm², 2,0 x 1,2 mm²). Die neuen Induktivitäten in der Baugröße 1608 sind mit Abmessungen von 1,6 x 0,8 mm² und einer Bauhöhe von weniger als 0,75 mm deutlich kleiner. Die Miniaturisierung der Bauelemente wurde durch ein verlustarmes Ferritmaterial ermöglicht, das auf TDK Materialtechnologie basiert. Werden die neuen kleineren Produkte anstatt von TDK MLP2012S-Bauelementen (1 µH) als Power-Induktivität im Stromversorgungskreis verwendet, dann lässt sich eine Reduzierung des Bauelementevolumens von mehr als 50 Prozent erreichen. Gleichzeitig bleibt die hohe Effizienz der Leistungsumwandlung bei Stromstärken von bis zu 100 mA erhalten. Die TDK MLP1608-V-Serie trägt somit zur weiter Verkleinerung von Stromversorgungsschaltungen in mobilen elektronischen Geräten bei.

Fortschrittliche mobile Geräte integrieren viele Funktionen und werden oft für eine lange Dauer betrieben. So belastet etwa das Spielen oder Nutzen der Kamerafunktion stark die Akkus. Die neuen TDK Power-Induktivitäten steigern die Effizienz der Stromversorgungsschaltung und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Verringerung des Stromverbrauchs. Sie sind damit bestens geeignet zur Anwendung in vielen verschiedenen mobilen Geräten.

Glossar

- Powerinduktivität: Bauelemente, die zur Rauschunterdrückung und Stromglättung in Stromversorgungskreisen wie etwa DC-DC-Wandlern verwendet werden.

Hauptanwendungsgebiete

- Drosseln in den Stromversorgungen von mobilen Geräten wie Smartphones, konventionellen Mobiltelefonen und Digitalkameras.

Haupteigenschaften und -vorteile

- Bis zu 50 Prozent weniger Volumen im Vergleich zur Serie 2012 bei gleichbleibender Effizienz.
- Dank geringem Gleichstromwiderstand und großer Nennstromstärke für ein breites Anwendungsspektrum geeignet.

Kenndaten

| Typ | Bauhöhe [mm] | Induktivität [μ H] | Gleichstromwiderstand [Ω] | Nennstrom [mA] |
|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|----------------|
| MLP1608VR47D | Max. 0,75 | 0,47 \pm 20% | 0,22 \pm 30% | 800 |
| MLP1608V1R0D | | 1,0 \pm 20% | 0,30 \pm 30% | 700 |
| MLP1608VR47B | Max. 0,95 | 0,47 \pm 20% | 0,20 \pm 30% | 800 |
| MLP1608V1R0B | | 1,0 \pm 20% | 0,30 \pm 30% | 700 |
| MLP1608V2R2B | | 2,2 \pm 20% | 0,36 \pm 30% | 600 |

Über TDK-EPC

Die TDK-EPC Corporation (TDK-EPC), ein Unternehmen des TDK Konzerns, ist ein führender Hersteller von elektronischen Bauelementen, Modulen und Systemen mit Sitz in Tokio/Japan. TDK-EPC ist aus dem Zusammenschluss des Bauelementegeschäfts von TDK mit dem EPCOS Konzern hervorgegangen und vertreibt seine Produkte unter den Produktmarken TDK und EPCOS.

Zu dem Produktspektrum gehören Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hochfrequenz-Bauelemente wie Surface Acoustic Wave (SAW) Filterprodukte und Module, Piezo- und Schutzbauelemente sowie Sensoren. Mit diesem Portfolio bietet TDK-EPC ein breit gefächertes Angebot an hervorragenden Produkten und Lösungen aus einer Hand und konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Automobil-, der Industrie- und der Konsum-Elektronik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika.

Den Text dieser Meldung sowie Bilder dazu können Sie unter www.tdk.co.jp/tdaah01/aah01500.htm herunterladen.

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.tdk.co.jp/tefe02/e533_mlp.pdf.

Kontakt für Medien

| Kontakt | Telefon | Mail |
|---|------------------|--|
| Frank TRAMPNAU TDK Electronics Europe GmbH Düsseldorf/Deutschland | +49 211 9077 127 | trampnau@eu.tdk.com |